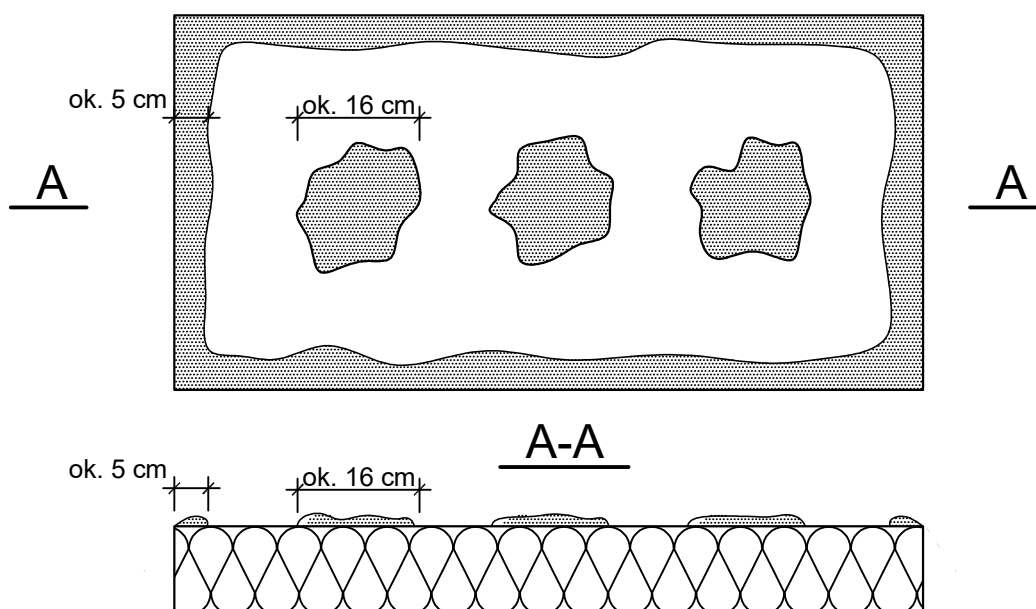
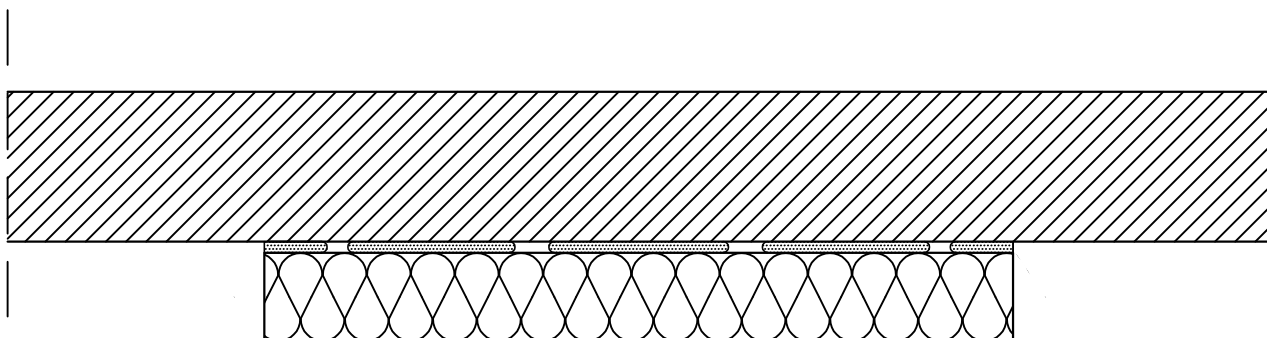


SPOSÓB KLEJENIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ



Uwagi!

Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspresyjnych mas klejowych w przypadku podłoży nienasiąkliwych i drewnopochodnych lub zapraw klejowych do mieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych. Zaprawę klejową należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje/karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspresyjnych, które wymagają mieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej. Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody pasmowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejania płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowane grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całościowo przy użyciu pasy zembatej (ok. 10mm).

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych producentów jest niedopuszczalne!

EKOPROBUD
Firma projektowo-wykonawcza

EkoProBud
Biuro projektowe: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65
tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.pl

ADRES INWESTYCJI:

Budynek mieszkalno - usługowy
Ul. 1 Maja 99 41-706 Ruda Śląska

TYTUŁ: **PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNO - USŁUGOWEGO
PRZY UL. 1 MAJA 99 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI**

TYTUŁ RYSUNKU:

SPOSÓB KLEJENIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ

BRANŻA:
ARCH.

ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. arch. L. Witański nr upr. 743/87

PODPIS:

02-2020

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. arch. Ł. Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK

PODPIS:

SKALA:
1:10

OPRACOWANIE:

mgr inż. M. Szatanik

PODPIS:

NR RYS.

KIEROWNIK BIURA:

dr inż. T. Muzyczuk

PODPIS:

6